



2016年5月吉日

お客様各位

株式会社 Hit-C
〒160-0022
東京都新宿区新宿 2-13-10 エルハイム新宿 903
TEL:03-6380-6081 FAX 03-6740-6088
広報担当 佐伯(さえぎ) e-mail: info@hit-c.biz

～thinkdesign をより使いやすく進化させたモジュール～ —Mold Focus があなたの3次元 CAD を加速させる—

株式会社 Hit-C (東京都新宿区新宿) は、この度韓国 FOV 社の金型設計効率化モジュール “モールドフォーカス” (http://moldfocus.com/fov/index_jp.php) の日本販売店契約を 2016 年 5 月 26 日に成立しました。FOV 社は 3D CAD システム thinkdesign の販売・カスタマイズするソフトウェア開発会社です。株式会社 Hit-C は日本国内の thinkdesign ユーザーを中心に年間 150 本の出荷を予定しており、thinkdesign(3次元 CAD) とのモールド設計 3次元 CAD パッケージも thinkdesign ユーザーで無い顧客層へ提案を企画しております。

FOV 社製モールドフォーカスは、その名の通り、金型設計支援用にフォーカスして作成されました。その開発目標は非常に高く、作業工程を 50%削減する事にフォーカスしております。

主な特徴

- ① 作業速度の向上 (クリック数を極限まで簡素化します)
- ② 基本機能の補完 (複数の作業を伴う作業を簡素化します)
- ③ 新機能の追加 (プログラム開発により機能追加します)

お客様のニーズにあわせて、4タイプのモジュールが年間使用料でご利用可能です。

(*永くライセンスパッケージもご用意しておりますのでお問い合わせください)

1) BASIC Package ￥100,000 (年間使用料)
thinkdesign で作成された 3次元 CAD データや取り込まれた 3次元データの詳細な情報や編集操作を使いやすくした基本パッケージです。

2) ELEC Package ￥125,000 (年間使用料)
3次元モデルから、必要な電極面や電極ボックスサイズはデータベースから検索し極限まで簡単に操作できるように作成されたパッケージです。EXCEL に作業指示書を自動出力する機能も含まれます。

3) CAV_CORE Package ￥110,000 (年間使用料)
金型設計で発生する製品の上下分離に必要な機能(パーティング面作成、上下分離機能など)をパッケージ化したモジュールパッケージです。

4) MOLDPackage ￥200,000 (年間使用料)
金型設計に必要な機能をフルに備えた最上位パッケージです。フタバのモールドベースも装備しており金型設計を極限まで効率化したモジュールパッケージです。